

ご注意：コロナウイルス (CoV) 対策のためにフォーラムにデリバリー手法について変更があります。

CIMdata 2020 PLM Market & Industry Forum

“Products, Smartly Connected”

”スマート製品、賢くつながる”

つながるスマート製品 (smart connected products - スマートコネクティッド製品) というフレーズは過去 5 年の間に流行ってきましたが、このアイデアは一部の業界ではもう何年も前から現実のものとなっています。最近急上昇して注目されているポイントは、安価なセンサー、コンピューティング、ユビキタスネットワークの出現であり、ほとんどの業界でつながるスマート製品の爆発的な普及を後押ししています。しかし、産業界の企業は、この賢く (スマートに) つながる世界で成功を収める準備はできているのでしょうか？ 弊社のリサーチやコンサルティングの経験が参考になるとしたら、ほとんどの企業での製品開発は、メカ、電気/電子、そしてソフトウェアにサイロ化されています。関連のツールやプロセスを使用して設計されたプリント回路基板のジオメトリを提供するなど、または、特定のタイミングで、製品の構築またはリリースを完了するために部品表 (bill of materials) にソフトウェアオブジェクトが添付されるなど、社はそれぞれ固有の方法で対応する必要があります。もちろん、すべての企業がこれらのプラクティスを使用しているわけではありませんが、これらサイロ間での相違とプロセスを融合させるベストプラクティスとはどのようなもののでしょうか？ 今年のフォーラムのセッションでは、業界が直面している課題・問題について論じ、業界の経験からいくつかのベストプラクティスを特定 & 明確にし、最新技術と実践を前に進めるために欠落しているものは何かについて示唆したいと考えます。

The phrase smart connected products has been in vogue for the last five years, but the idea has been a reality in some industries for many more years. Its recent and significant rise in focus is the advent of cheap sensors, computing, and ubiquitous networks that fostered the explosion of smart connected products in most industries. But are industrial companies ready to thrive in this smart connected world? If our research and consulting experience are any guide, product development at most companies is siloed by mechanical, electrical/electronic, and software. They have to meet in certain ways, such as providing the geometry for printed circuit boards designed using other tools and processes, or at certain times, such as when a software object is attached to a bill of material to complete a build or release of the product. Of course, not all companies are using these practices, but what are the best practices in melding these very different siloes and processes? The sessions at this year's Forum will discuss the problems facing industry, identify some best practices from industrial experience, and to suggest what is missing that could move the state of the art and practice forward.

背景

過去 30 年間でコンピュータは、処理能力が向上し続け、コストの低減で利用できるメモリーは増え続け、大きな進歩が見られます。組込型ソフトウェアを備えた初期の製品は、航空宇宙 & 防衛アプリケーション向けに開発され、通常は、専用ハードウェア上の専用アプリケーションとして提供されていました。一般的なポケット電卓 (ご記憶でしょうか?) は、アポロ月面計画 (Apollo moon missions) で使用されたものよりもはるかに高い計算能力を備えていました。iPhone は、1980 年代のスーパーコンピューターよりもパワフルです。1980 年代に利用可能だったつながるスマート製品は、障害を診断して、タイムリーで正確なメンテナンスを確実にするために電話で伝えました。安価なコンピューティング、センサー、そしてユビキタスネットワークの出現により、より多くのアプリケーションでつながるスマート製品が経済的に実行可能になりました。多くの製品では、顧客価値の大部分はソフトウェアを介して提供されます。最近の CIMdata のリサーチでは、つながるスマート製品はさまざまな業界の製造業の成功にとってますます重要であることを示唆しています。96% は、つながるスマート製品が社の市場での成功にとって重要あるいは非常に重要であると答えています。

これらの製品がスマートでつなげるには、産業界の企業は、電気および電子設計 (場合によってはチップまで) およびソフトウェア開発を含むように、製品ライフサイクル管理の戦略及び実装を拡張する必要があります。これらの各分野には、異なったツール、開発および管理プロセス、そしてタイムスケールがあります。弊社のリサーチや業界でのコンサル

ティングの経験に基づいて、産業界のほとんどの企業はせいぜい、製品開発で事前に定義されたマイルストーンに必要な作業成果物の生成に、サイロ化された開発スレッドを細かく準備・調整しているに過ぎません。本当の意味での“真の単一情報源 (single source of truth)” は、それぞれが各分野の独自のデータおよびプロセス管理のソリューションに引き込み、ひいき目に見ても論理的に単一であるに過ぎません。

それにはより良い方法がある筈です。本年のフォーラムでは、ライフサイクル開発とつながるスマート製品の管理に関して業界が直面している課題・問題について議論し、ベストプラクティスを確認し、最新技術とプラクティスを取り入れるために欠落している点などを示唆します。例えば、CIMdata はシステムズエンジニアリングの Vee (所謂、Vee Model、V 字モデル) について長年にわたって語ってきました。システム要件は、メカ、電気/電子、およびソフトウェアコンポーネントへのシステムの分析・分解 (decomposition) を支援するために行われるトレードスタディであり、その左側 (Vee) について詳述されます。疑いもなく、強固な要件管理機能は重要な成功要因であり、機能的、論理的、物理的モデリングの進歩があります。

部品表 (BOM - The bill of material) は、製品データ管理が始まって以来その中核でした。製造 BOM を作成するためにエンジニアリング BOM を変換する必要があり、つぎに、“as-“ BOMs に、つまり、as-manufactured BOM (製造した状態)、as-installed BOM (設置した状態)、また as-maintained BOM (保守した状態) などに変換する必要があります。より多くの企業がサービスとしての製品 (product-as-a-service) 戦略を追求するにつれて、すでに定着している BOM から始めて、as-maintained BOM (保守した状態) を管理することは、サービスレベル契約 (SLA) を実現するために不可欠です。ある種の企業は、進化・発展している製品でデジタルツインを展開し、シミュレーションを使用して障害そして適切な保守且つ/または改善のアクションの評価・判断にそれらを同期させようとしています。今日、これを実現するために企業が利用しているツールとプロセスはどのようなものか、プロセスを強化するのにどのようなものが役立つのでしょうか？

PLM エコノミーで推進されている IoT のさらなる利点 (another benefit) は、クローズドループでの製品ライフサイクル管理です (たとえば、フィールドから開発へ、製造から開発へ、フィールドから製品管理へ)。センサーは、さまざまな現象・事象を対象とし、大量のデータをマイニングしてフィールドにおける製品の問題を特定することができます。問題が発生した場合、ライフサイクル全体のループバックをつないで閉じる (所謂、フィードバックループ) 最良の方法はどのようなもののでしょうか？医療機器業界の CAPA プロセス (是正処置/予防措置) での各社の良い手本があり、問題の原因が特定され、潜在的な是正処置が明確になるまで、問題を上流に戻して調査されるということです。如何にしてそのようなデータから考え得る改善を特定して明確にすればよいのでしょうか？プロセスのどこでこれらの考え得る改善を行ったらよいのでしょうか？ソリューションプロバイダーからの答えは、デジタルスレッドをサポートするためにどのソリューションで構築するかによって異なるように見えます。

CIMdata の 2020 PLM Market & Industry Forum

業界でもっとも重要なこのフォーラムで、CIMdata はベストプラクティスを調査・探求し、つながるスマート製品を開発するためのプロセスとツールのギャップを特定し明確にします。CIMdata では、これまでの働きが、可能性あるものが何かであるかについて少なからず触れていると信じています。IoT や AI / ML などの実現技術の多くは、採用のライフサイクル初期段階にあるため、習得を促進する多くの試みがまだまだあります。これらの話題により、CIMdata は、顧客と市場の要件を満たし、それを超えてつながるスマート製品のエンジニアリングに関するお話で始めたいと考えています。

CIMdata の 2020 PLM Market & Industry Forum (2020 年度 PLM 市場&業界フォーラム)、PLM エコノミーのソフトウェアおよびサービスプロバイダー向けのリーディングイベントは、弊社の PLM コミュニティメンバーおよび世界の PLM 市場についてさらなる識見・洞察を得たい企業にとって重要な成果物を呈示する場です。2020 年度のフォーラムは、現行の経済情勢と動向の識見・洞察を提供し、上記の課題と機会についてフォーカスして PLM エコノミーへの影響を精査します。CIMdata の PLM 市場の現行状況と将来のトレンドについての視点が、CIMdata の 2019 年グローバル PLM 市場分析の最初の一般公開の場として詳細に提示し、それには PLM 領域、産業別、地域別など全体の市場について広範な分析と予測、大手 PLM ソリューションプロバイダー (収益と市場シェア) の実績などを含みます。

CIMdataのPLM Market & Industry Forum イベントのご参加の皆さまには、現行と新たに展開・発展するPLM市場、そのダイナミックな影響、継続的な市場の進展について確かなる理解を深められることを期待するものです。出席者は、自身・自社が活用できるチャンス、また今後1年間のPLM市場環境をナビゲートするために利用できるアプローチなどに先見性ある識見を高めることとなります。このイベントはまた、競合相手・他社、コラボレータ・協力者、また潜在的なパートナーを含み、PLMコミュニティに於ける専門家たちとのネットワークの機会も提供します。本プログラムの登録は、<http://www.cimdata.com/> をご覧ください。

Background

The last thirty years have seen great advances in computing, with ever increasing power and memory available for a decreasing cost. Early products with embedded software were developed for aerospace and defense applications—usually delivered as specialized applications on specialized hardware. A common pocket calculator (remember them?) had more computing power than what was used for the Apollo moon missions. iPhones are more powerful than supercomputers of the 1980s. Smart connected products that were available in the 1980s could diagnose their faults and phone home to ensure timely and accurate maintenance. The advent of cheap computing, sensors, and ubiquitous networking made smart connected products economically viable for many more applications. For many products most of the customer value is delivered via software. Recent CIMdata research suggests that smart connected products are increasingly important to the success of industrial companies in a range of industries. 96% say smart connected products will be important or very important to their market success.

Making these products smart and connected requires industrial companies to expand their product lifecycle management strategies and implementations to include electrical and electronic design (and sometimes down to the chip) and software development. Each of these disciplines has different tools, development and management processes, and timescales. Based on our research and industrial consulting experience, most industrial companies are, at best, finely orchestrating their siloed development threads to yield the needed work products at pre-defined milestones in product development. The “single source of truth” is at best logically single, with each discipline retreating to their own data and process management solutions.

There has to be a better way. At this year’s Forum we plan to discuss the problems facing the industry around lifecycle development and managing smart connected products, to identify some best practices, and suggest what might be missing that could advance the state of the art and practice. For example, CIMdata has spoken about the systems engineering Vee for many years. The system requirements are elaborated down the left hand side, with trade studies conducted to support the system decomposition to mechanical, electrical/electronic, and software components. Clearly, strong requirements management capabilities are central to success and advances in functional, logical, and physical modeling show promise.

The bill of material (BOM) has been core to product data management since the beginning. The engineering BOM must be transformed to create the manufacturing BOM, and then you get into the “as-” BOMs, i.e., the as-manufactured BOM, the as-installed BOM, and the as-maintained BOM. As more companies look to pursue product-as-a-service strategies, starting with a known BOM and managing the as-maintained BOM will be essential to delivering on their service level agreement (SLA). Some are looking to evolve their digital twin with the evolving product, keeping them in synch to use simulation to assess faults and possible maintenance and/or improvement actions. What tools and processes are companies using to make this happen today, and what could help enhance the process?

Another benefit of the IoT promoted in the PLM Economy is closed-loop product lifecycle management (e.g., from the field to development, from manufacturing to development, and from the field to product management). Sensors can be targeted to a wide range of phenomena, delivering massive amounts of data to be mined to identify product issues in the field. When issues arise, what are the best ways to close the loop back through the lifecycle? We have a good example from the medical device industry with their CAPA process (Corrective Action/Preventive Action), where issues are investigated back upstream until the source of the issue is identified and a potential corrective action identified. How do we best identify possible improvements from such data? Where in the process do we take those possible improvements? The answer from the solution providers seems to vary depending on what solutions they decide to build in support of a digital thread.

CIMdata’s 2020 PLM Market & Industry Forum

In this industry leading forum, CIMdata will explore best practices and identify gaps in the processes and tools for developing smart connected products. CIMdata believes that the work to date barely scratches the surface of what is possible. Many of the enabling technologies, like the IoT and AI/ML, are early in their adoption lifecycle so there is still a lot experimentation driving learning. With

these talks, CIMdata hopes to kickstart the conversation on engineering smart connected products that meet and exceed customer and market requirements.

CIMdata's 2020 PLM Market & Industry Forum, the leading event exclusively for software and services providers in the global PLM economy, is a key deliverable for our PLM Community members and those companies wishing to gain additional insight into the global PLM market. The 2020 Forum will provide insights on the current economic climate and trends, as well as examine their effects on the PLM economy, focusing on the challenges and opportunities highlighted above. CIMdata's perspective on the current state of the PLM market and trends for the future will be presented in detail, as will the first public release of CIMdata's 2019 global PLM market analysis results—including extensive analyses and forecasts regarding market growth across PLM domains, industries and regions, and the performance (by revenue and market-share) of leading PLM solution providers.

Participants in CIMdata's PLM Market & Industry Forum should expect to gain a solid understanding of the current PLM market and the dynamics impacting it, and develop realistic expectations for continued market evolution. Attendees will gain further insights into opportunities they can exploit and approaches they can use to navigate the PLM market environment in the year to come. This event also provides the opportunity to network with other professionals in the PLM Community, including competitors, collaborators, and potential partners. To register for this program, please visit www.CIMdata.com.

開催日 & 開催地 (Dates and Locations)

ご注意：コロナウイルス (CoV) 対策のためにフォーラムにデリバリー手法について変更があります。

- 3月25日 (水) :** 北米 - バーチャルイベント (North America - Virtual Event)
Wednesday, 25 March 2020 - SESSION 1
Tuesday, 7 April 2020 - SESSION 2
Thursday, 9 April 2020 - SESSION 3
- 4月2日 (木) :** 欧州 - バーチャルイベント (Europe - Virtual Event)
Thursday, 2 April 2020 - SESSION 1
Tuesday, 7 April 2020 - SESSION 2
Thursday, 9 April 2020 - SESSION 3
- 4月6日 (月) :** インド - プネー (India - Pune, INDIA)
- 4月10日 (金) :** 中国・上海 (Shanghai, CHINA)
- 4月14日 (火) :** 日本 - バーチャルイベント&オンサイトイベント (JAPAN - Virtual Event & Onsite Event)
2020年4月14日 (火) - バーチャルイベント - バーチャルセッション (Virtual Event - Web Session)
2020年10月15日 (木) - オンサイトイベント (オンサイトセッション)
東京ガーデンパレス、東京都文京区湯島 1-7-5 (Tokyo Garden Palace @Tokyo)

CIMdata 2020 PLM Market & Industry Forum - JAPAN

AGENDA

バーチャルセッション (Virtual Session)

2020年4月14日 (火)

8:50 a.m. Web セッション オープン (Open Web Session)

9:00 a.m. – 9:10 a.m. 開催にあたって (Welcome)

江澤 智、CIMdata日本代表/メタリンク

(Satoshi Ezawa, A Japan Representative of CIMdata / MetaLinc)

9:10 a.m. – 10:10 a.m. PLMの状況 - 現行市場並びに最新トレンド

(State of PLM - Today's Market and Leading Trends)

ピーター・ビレロ、CIMdata 社長 & CEO (Peter Bilello, Presiden & CEO)

このセッションではPLMソフトウェアとサービスプロバイダーにとって重大である、つながるスマート製品 (smart, connected products)、それ以外の進みつつあるトレンドや必須事項を含み、特定のトレンドと課題に重点を置いてPLM業界の現行状況をレビューします。CIMdataは、これらのトレンドと、ますます厳しさが増すこの市場について参加者への影響の見解を説明します。さらに、ビレロ氏は、進化するPLMエコノミーとこれらのトレンドに対してCIMdataがどのように対処しているかについての最新情報を提供します。

This session will review the current state of the PLM industry with particular emphasis on trends and issues, including how smart, connected products, and other emerging trends and necessities that are critical to PLM software and service providers. CIMdata will present its views on these trends and the impact they have on participants in this increasingly challenging market. In addition, Mr. Bilello will provide an update on how CIMdata is addressing the evolving PLM economy and these trends.

10:10 a.m. – 11:10 a.m. 2019 年度市場分析結果 (2019 Market Analysis Results)

スタン・ブルジビリンスキー (CIMdata VP (Stan Przybylinski, Vice President)

PLM業界の進展と方向性への包括的且つ正確な識見を持つ最善な情報源として長年に渡って認められているCIMdata 年次PLMグローバル市場の分析は、本PLM Market & Industry Forumでまず最初の公開となります。さらなる詳細はCIMdata PLM MAR seriesにレポートされます。

Recognized for many years as the best source of comprehensive and accurate insights into the evolution and direction of the PLM industry, CIMdata's annual PLM Global Market Analysis is first revealed at this PLM Market & Industry Forum that will be further detailed and reported in the CIMdata PLM MAR series reports.

11:10 a.m. – 11:40 am. 2019 年度 日本&AP 市場分析結果

(Japan & AP - 2019 Market Analysis Results Japan & AP)

江澤 智 (Satoshi Ezawa)

本セッションは、日本市場の分析を中心に 2019 年度の状況、トレンド、課題について解説します。

This session describes results, trends and issues based on the analysis of mainly Japanese market on 2019.

11:40 a.m. – 11:50 a.m. Q&A

11:50 a.m.. Web セッション クローズ (Close Web Session)

オンサイトセッション (Onsite Session)

東京ガーデンパレス 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5
2020年10月15日(木)

10:15 a.m. オンサイトセッション受付オープン (Open for Onsite Session)

午前の部 (Morning Session)

10:30 a.m. – 12:00 a.m. アップデート：以下の3つの2020上半期のアップデートをハイライトします。

(Updates: highlights the following three first half 2020 updates:)

(1) PLMの状況 - 現行市場並びに最新トレンド

(State of PLM - Today's Market and Leading Trends)

(2) 2019年度市場分析結果 (2019 Market Analysis Results)

(3) 2019年度 日本&AP市場分析結果 (Japan & AP - 2019 Market Analysis Results Japan & AP)

ピーター・ビレロ (Peter Bilello)

江澤 智 (Satoshi Ezawa)

12:00 a.m. – 1:00 p.m. 昼食&ネットワーキング (Lunch & Networking)

午後の部 (Afternoon Session)

1:00 p.m. – 3:00 p.m. “製品、スマートにつながる”に焦点を当てる Focus on “Products, Smartly Connected”

今日、製造されたほとんどの製品は、そうであるべきかどうかにかかわらず、スマートでありつなっています。この午後のセッションでは、このような製品を開発する企業が直面する問題に焦点を当て、これらの進化する要件を満たすために、業界が開発&ライフサイクル管理プロセスを改善する方法についていくつかの洞察を提供します。

Today most manufactured products are smart and connected, whether they should be or not. This afternoon session focuses issues faced by companies developing such products and offers some insights into how industry might improve their development and lifecycle management processes to meet these evolving requirements.

1:00 p.m. – 1:40 p.m. サイロ化された開発の同期 (Synching Siloed Development)

成功しているエンジニアリング/製品企業でのプラクティスでは、エンジニアや技術者のチームが主要なマイルストーンで、量産に向けて進捗と準備状況を評価して活動・作業 (efforts) を同期させて行うコンカレントエンジニアリングを使用しています。同期の本来の動機は、アディティブマニファクチャリングやアジャイル開発などの新しいテクノロジーやプロセスに困難なものにしています。新しいツールやアナリティクスは、製品ライフサイクル全体に役立つものです。このセッションでは、今日の製品ライフサイクルの課題に対処するために、サイロ化された開発をどのように進化させれば良いかに焦点を当てます。

The practice at successful engineering/product companies uses concurrent engineering performed by teams of engineers and technicians synchronizing their efforts at key milestones to assess progress and readiness for mass production. The original motivations for synchronization are being challenged by new technologies and processes like additive manufacturing and agile development. New tools and analytics can help across the product lifecycle. This session will focus on how siloed development must evolve to meet today's product lifecycle challenges.

1:40 p.m. – 2:20 p.m. ライフサイクル全体にわたるxBOM管理 (xBOM Management Across the Lifecycle)

電子部品・コンポーネントの陳腐化は、つながるスマート製品、特に長寿命の製品では重大な問題です。デジタルツインは、このビジネス上の問題に効果的に対処するための最良のアプローチです。本プレゼンテーションでは、産業界の企業が直面する問題と、異なるBOM間にまたがるデータをつなぐ適切に実装されたデジタルツインが、部品・コンポーネントの陳腐化の影響を如何に低減できるか述べます。

Electronic component obsolescence is a critical issue with smart connected products, especially those with long lifespans. Digital twins are the best approach to effectively address this business problem. This presentation will describe the issues faced

by industrial companies and how a properly implemented digital twin that connects data across different BOMs can reduce the impact of component obsolescence.

2:20 p.m. – 3:00 p.m. クローズドループ製品開発 (Closed-Loop Product Development)

つながるスマート製品の約束の1つは、IoTを使用して製品のパフォーマンスデータを取得し、このデータを活用して製品およびその他の関連するライフサイクルプロセスを改善できることです。しかし、如何にしてこれを正確に行ったらよいでしょうか？ 一つ、答えとして言えることは、ソリューションプロバイダーごとに異なることです。本セッションでは、人々がこの問題にどのように取り組んでいるかに焦点を当てます。

One of the promises of smart connected products is being able to capture product performance data using the IoT and to leverage this data to improve the product and other associated lifecycle processes. But how is this done exactly? The answer one gets is different for each solution provider. This session will focus on how people are addressing this issue.

3:00 p.m. – 3:15 p.m. ネットワーキング・ブレイク (Networking Break)

3:15 p.m. – 4:45 p.m. トレンド - ホットトピックス (Short Takes on Hot Topics)

このセッションでは、全体的なテーマとPLMエコノミー全般に関連するトピックの最新情報を提供します。

These sessions will provide updates on topics relevant to our overall theme and the PLM Economy at large.

3:15 p.m. – 3:45 p.m. A&D Action Group のリサーチ (A&D Action Group Research)

CIMdataは、主要なA&D OEMおよび主要なサプライヤーに代わって、航空宇宙および防衛 (A&D) PLMアクショングループをアドミニストレーションしています。このセッションでは、グループに代わって進行中のリサーチに関する最新情報を提供します。

CIMdata administers the Aerospace & Defense (A&D) PLM Action Group on behalf of the leading A&D OEMs and leading suppliers. In this session we will provide an update on on-going research being conducted on behalf of the group.

3:45p.m. – 4:15 p.m. アジャイル手法&PLM (Agile Methodologies & PLM)

アジャイルはソフトウェア開発を引き継いでおり、主要なPLM展開方法論へと大きく進出しています。エンタープライズへの展開には、アジャイルと対立するいくつかの固有の要件があります。本プレゼンテーションでは、アジャイルを使用して企業内のPLMソリューションの展開に関連する問題と解決策 (remedies) のいくつかについて述べます。

Agile has taken over software development and is making significant inroads into becoming the dominant PLM deployment methodology. Enterprise deployments have some unique requirements that conflict with agile. This presentation will describe some of the issues and remedies associated with using agile to deploy PLM solutions within the enterprise.

4:15 p.m. – 4:45 p.m. IoTとスマートでつながるライフサイクルループを結ぶ (クローズ)

(Closing the Smart, Connected Lifecycle Loop with IoT)

いくつかのつながるスマート製品 (エレベーターなど) は数十年前から存在していましたが、IoTと比較的安価なセンサーの出現により、スマートでつながる製品が一般的になりました。本プレゼンテーションでは、スマートでつながるライフサイクルループをクローズするために使用されているIoT関連テクノロジーの現在状況を簡単に紹介し、この急速に進化するテクノロジースペースに影響を与えると予想されるテクノロジーの兆しがどんなものであるかを紹介します。

While some smart, connected products (e.g., elevators) have been around for a few decades, the advent of the IoT and relatively inexpensive sensors have made smart, connected products common place. This presentation will briefly take a look at the current state of IoT related technologies being used to close the smart, connected lifecycle loop and what technologies are on the horizon that are expected to make an impact on this rapidly evolving technology space.

4:45 p.m. – 5:00 p.m. 纏め&終わりにあたって (Closing Comments)

ピーター・ビレロ (Peter Bilello) & 江澤 智 (Satoshi Ezawa)

5:00 p.m. – 6:30 p.m. ネットワーキング・レセプション (Networking Reception)

開催場所：東京ガーデンパレス (<http://www.hotelgp-tokyo.com>)

所在地：〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211 (代表)

交通アクセス：(詳細は、<http://www.hotelgp-tokyo.com/map/index.html>)

最寄駅：JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口(東京駅寄りの改札)より徒歩5分

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分

東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩8分



CIMdata 2020 PLM Market and Industry Forum - 2020 開催&参加要項

(必ずお読み下さい)

ご注意：コロナウイルス (CoV) 対策のためにフォーラムにデリバリー手法について変更があります。

CIMdataの2020年度のCIMdata PLM Market & Industry (PLM市場&業界フォーラム) は、あらゆる規模のPLMソリューションプロバイダーへの最高の業界イベントとなります。本年度のテーマは、“**Products, Smartly Connected (スマート製品、賢くつながる)**” としています。CIMdataと出席者は、現在のPLM市場が直面している課題を共有し、論じます。セッションは、現行経済情勢へのインサイト、PLMエコノミーでのPLMソリューションプロバイダーの取組みについて明らかにします。それらには、現行並びに将来のPLM市場の状況と動向についてのCIMdataの展望；2019年のPLM市場の結果についてのCIMdataの分析の最初ともなる一般公開 (PLM領域、業種、地域、及び大手PLMソリューションプロバイダーについての市場全体の成長の徹底的な初期分析と見通し) を含み、詳細なプレゼンテーションを行います。

CIMdataのPLM市場&業界フォーラムの参加関係者は、現行PLM市場の状況、そのダイナミックな影響、その継続的な進展の期待・予想などの強固な確かなる理解を深めることとなります。出席者の皆さんは、自身が来る年へのPLM市場環境をしっかりと進むために利用出来るアプローチと機会へのさらなるインサイトを高めることとなります。CIMdataのPLM市場&業界フォーラムは、競合相手、コラボレータ、また今後の潜在的なパートナーを含むPLMコミュニティに於ける他社のプロフェッショナルの皆さんとのネットワークの機会も提供します。

CIMdata 2020 PLM Market & Industry Forum - JAPANは以下のように予定します：

- **本年に限り、以下の2部作 (Two-Part Single Event) とさせていただきます。**
- **バーチャルイベント：日時：2020年4月14日 (火) 午前10時より**
 - 登録者には接続情報を事前に案内します。
- **オンサイトイベント：日時：2020年10月15日 (木) 午前10時30分より (受付開始：午前10時15分)**
 - 場所：東京ガーデンパレス 2F 天空の間 (東京都文京区湯島1-7-5)
- **参加対象：PLMソフトウェア&サービスのプロバイダー様**

ご出席に際して：

- 本年に限り、15%オフの**統一価格**として、早期登録割引 (“Early Bird Discount”) 価格にて受付します。
- 本体価格73,100円 (80,410円：消費税込み) となります。
- これはバーチャルイベントおよびオンサイトイベントのTwo-Part Single Eventとして2部作イベントのパッケージ価格となります。
- CIMdata PLM市場調査にご協力いただいた皆さま：特別割引をいたします。詳細についてはお申込の際にお問い合わせください。
- 同一組織内に於いて、複数のご参加については、二人目以降については割引 (20%オフ) を適用します。但し、**同一申し込みにてお願いいたします。**
- オンサイトイベントには上記価格に昼食&ネットワーキング、リフレッシュメントを含みます。
- 資料については、バーチャルイベント、オンサイトイベントそれぞれで提供します。
- 本年度も、プレゼン資料、英語文/日本語文混合での製作を進めるべく準備をしております。一部の日本語は、後日になります。
- 参加費のお支払いはフォーラム前日までをお願いいたします。
- 当日、申込者をご出席出来ない場合は必ず代理の方をお願いいたします。
- お申し込みは、所定の申込書をご参照&ご利用願います。PDFファイルを印刷いただきダイレクト入力、あるいは手書入力いただきメールの添付にて。

本年度も皆さまのフィードバック並びに私どもの経験を踏まえ、時代やビジネス環境に見合ったより充実した内容を提供&共有する所存です。皆様のご期待に添うべく計画を進めております。

本フォーラムの特徴は以下の通りです：

- 2020年は弊社が日本に於いてCIMdataとして1997年にPLM関連（当時はPDM）のフォーラムを開催して24年目となります。この間、フォーラムはユーザー向け、プロバイダー向けへとグローバルに先鞭をつけ発展し、ユーザー向けについては、プロバイダー各社の進展に伴い発展的解消、プロバイダー向けはグローバル共通プログラムの開発を進めて今日に至っています。
- 昨年に引き続き、今回の開催場所である東京ガーデンパレスは、当時プロバイダー向けフォーラムが立ち上がった際の記念すべき地です。例年同様に本フォーラムの発展を祈念し、原点であるこの地で心を新たな志をもってさらなる改善・改良を加えて運営する所存です。
- 昨年に引き続き、CIMdataの社長&CEOのピーター・ビレロ（Peter Bilello）、またVPのスタン・プラバンスキー（Stan Przybylinski）、そして江澤（CIMdata日本代表、メタリンク）と3人体制にてお届けします。ぜひネットワーク含め終日、ご参加の皆さまとぜひこの機会に活発且つ忌憚のない意見を交わしていただけると期待します。
- 東京のほかに、米国（ミシガン州アナーバ）、欧州（ドイツ・フランクフルト）、またインド（プネー）& 中国（上海）、と世界5都市で開催、さらなる進展となるグローバルベースで開催を鋭意進めています。
- 本年度は、企業のビジネスニーズへのPLMのデリバリー能力の進展に伴い “Products, Smartly Connected（スマート製品、賢くつながる）” としております。世界経済の不確実性は普通な状態（Norm）になった今日ですが、それは新たな規範（Norm）でもあり、PLMのビジネスへの明確なる貢献を認識し、今後の浸透をさらに高めるものです。過去、PLM業界として最も重要なメッセージを以下のように毎年、掲げて参りました：
 - 2019年 - “拡張知能：製品ライフサイクル全体のアプリケーション（Augmented Intelligence: Applications Across the Product Lifecycle）”
 - 2018年 - “インダストリー4.0 - そのグローバルインパクト&ステータス（Industry 4.0 - Its Global Impact & Status）”
 - 2017年 - “PLM：デジタル化へのキーイネーブラー”（PLM: A Key Enabler for Digitalization）
 - 2016年 - “素材の世界：あらゆるモノ・コトを変える”（It's a Material(s) World: This Changes Everything）
 - 2015年 - “イノベーションをするためのプラットフォーム：PLMの次なる進化のステップ（Platforms for Innovation: PLM's Next Evolutionary Step）”
 - 2014年 - “循環経済に向かって：新たな試練が新たなチャンスをもたらす（Moving Toward a Circular Economy: New Challenges Offer New Opportunities）”
 - 2013年 - “デシジョン！（Decisions, Decisions）”
 - 2012年 - “すべて真なり（The Whole Truth）”
 - 2011年 - “PLM - バック・トゥ・ザ・フューチャー（PLM - Back to the Future）”
 - 2010年 - “PLM - 業績回復を加速する（PLM - Accelerating the Recovery）”
 - 2009年 - “不確実な経済時に於けるPLM（PLM in Uncertain Economic Times）”
 - 2008年 - “大手企業のサプライヤーに出現：すべての関係者への新しい機会（The Emergence of Large Enterprise Suppliers: New Opportunities for All）”
 - 2007年 - “PLMの熟成：成功のためのコミュニティの戦略（PLM Matures: The community's strategy for success）”
 - 2006年 - PLMの拡大 - 新たな業界の要件（PLM Expansion - Requirements in Emerging Industries）
 - 2005年 - プラットフォームとPLMの進展（Platforms and PLM Evolution）
- 上記の各セッションは例年通り、ワンツーフンの日本語への逐次通訳は行いません。それにより得られる時間をより充実したプレゼンに振り向けると共に出席者皆さまのご理解を深めるために各セッション（ないし項目）毎に重要ポイントの簡便明瞭な解説（日本語）をインタラクティブに行います。
- プレゼン資料について、例年のように事前配布は出来ませんことをご容赦下さい。また日本語にての配布も必要且つ重点的なものについてすべく進めております（一部、開催後になることがあります。最終版は後日となります）。

以上のようなです。更に全体の構成の中で、私どもと皆さま、また出席者間の意見交換の改善に務める所存です。どうぞ、この大きな変化をご活用いただくと共にご理解のほどよろしくお願い申し上げます。ぜひ、現状をより正しく理解、課題を共有いただき、皆さまに於かれて有益なものになるもとの信じております。

CIMdataについて

CIMdata (大手独立系ワールドワイド企業) は、製品ライフサイクルマネジメント (PLM - Product Lifecycle Management) のアプリケーションの適用・利用を通して、イノベティブな製品やサービスをデザインし提供をする企業の能力を最大限にする戦略的マネジメントコンサルティングを提供しています。1983年に創業以来、CIMdataはPLMソリューションに於けるワールドワイドクラスのナレッジ、専門的な技術、ベストプラクティスメソッドを提供して参りました。これらソリューションはビジネスプロセス並びにPLMを実現する広範囲なテクノロジーに組み込まれています。

CIMdataは、グローバル経済の中で競争優位を模索している産業界の企業並びにテクノロジーやサービスのサプライヤーの両者と仕事をしております。CIMdataは効果的なPLMを確立する産業界の企業を支援し、要件の確認・検証やPLMテクノロジーの選択の援助、ソリューションを導入・実装するためにそれら企業の組織構成やプロセスを適なものにする支援、それらソリューション展開の支援を進めています。PLMのソリューションサプライヤーに対してCIMdataは、彼らの市場に於いて最も望ましい効果あるものにするためにあらゆるビジネスと製品プログラムの段階での全体の支援と共に、ビジネスや市場戦略の定義&確立の支援、ワールドワイドの市場情報と分析のサービス、社内の販売やマーケット部門への教育やサポートを提供しています。

コンサルティングに加えてCIMdataは、リサーチを進め、PLMに特化した購読サービスの提供、数々の商業パブリケーションを制作しています。当社はさらに全世界でPLM certificate programs (PLMに関する認定プログラム)、セミナーやカンファレンスを通して業界に教育を提供しています。CIMdataは北米、欧州、またアジアパシフィックのオフィスから全世界の顧客にサービスを提供しています。

CIMdataのサービスの詳細については、Webサイト (<http://www.cimdata.com/>) をご覧いただくか、CIMdataの次の連絡先まで：3909 Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, USA. Tel: +1 (734) 668-9922. Fax: +1 (734) 668-1957；または、Oogststraat 20, 6004 CV Weert, The Netherlands. Tel: +31 (0)495.533.666

米国 CIMdata 日本代表 メタリンク株式会社

<https://www.metalinc.com>

TEL 047-361-5850 FAX 047-362-0472

〒271-0071 千葉県松戸市竹ヶ花西町 310-31

CIMdata 2020 PLM Market & Industry Forum - JAPAN 申込書 (PDF入力可)

本フォーラムご出席お申込はこの用紙に必要事項をご記入の上、下記のいずれかの送付先にお送り下さい。ご記入は楷書にて、またお手数ですが () 内にローマ字も併記下さるようお願いいたします。

開催&参加要項に同意し、CIMdata 2020 PLM Market & Industry Forum - JAPAN (CIMdata 2020年度 PLM市場&業界フォーラム：バーチャル&オンサイトイベント) を申し込みます：

お名前： _____

(Name: _____)

会社名： _____

(Company : _____)

部署名： _____

(Dep./Div.: _____)

役職： _____

(Title : _____)

住所-1：〒 _____

(Address-1: 〒 _____)

住所-2： _____

(Address-2: _____)

電話/TEL： _____

電子メール/E-mail： _____

通信欄：

本フォーラム受講申込書をいただきますと、受講票並びにご請求書をお送り致します。
この申込書にご記入のうえ、お送りください。(複数人の場合にはコピーして下さい)

メタリンク社行 (担当：二村) ファックス：047-362-0472

郵送：〒271-0071 千葉県松戸市竹ヶ花西町310-31

(註) PDF入力したシートは添付で Ezawa@MetaLinc.com 宛でお願い出来れば幸いです。

日時：2020年4月14日(水) 午前9時45分開始 (午前9時30分受付開始)

場所：東京ガーデンパレス (<http://www.hotelgp-tokyo.com>)

所在地：〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5 TEL.03-3813-6211 (代表)